

TEANMO



求められる最先端を
「人」の視点から創造する企業。
それがTAZMOです。

Creating the cutting edge
through a human perspective.
We are TAZMO.



Top Message

私たちタツモはハイテクノロジーとヒューマニズムの接点を求め、常に技術革新に取り組んでいます。

その根底にあるのが、豊かで幸せな社会を築くための挑戦心と想像力です。

精密加工&ファインメカトロニクス分野の発展に尽くす独自の技術は、国内外で高い評価を受け、タツモへの期待はますます高まっています。

私たちはこれからも「人のためのテクノロジー」にこだわりながら、求められる最先端に挑み続けてまいります。

At TAZMO, we strive to find the intersection between high technology and humanism, constantly pursuing technological innovation. This unwavering commitment is driven by a spirit of challenge and imagination, aiming to build a prosperous and fulfilling society. Our unique technologies, dedicated to the advancement of precision processing and fine mechatronics, are highly regarded both in Japan and abroad, and expectations for TAZMO continue to grow. Moving forward, we will remain committed to “technology for people” as we continue to take on the forefront of innovation.

Yasuyuki Sato
President and Representative Director



代表取締役社長 佐藤 泰之

人としての優しさと卓越した創造力を基本に、
あくなき「挑戦」によって、
豊かな未来社会の創造に貢献する

Guided by human kindness, fueled by creativity,
and driven by an unyielding spirit, we contribute to shaping a prosperous future.
That is TAZMO's philosophy.

History

1972

電子機器部品の製造及び設備の修繕を目的として
岡山県井原市西江原町に資本金300万円をもって、
タツモ株式会社を設立

TAZMO CO., LTD. was established in Nishi Ebara-cho, Ibara City, Okayama, with a capital of 3 million yen to manufacture electronic components and repair industrial equipment.

1980

半導体製造用全自動レジスト塗布装置を
開発、製造・販売を開始

Developed a fully automated photoresist coater and launched production and sales.

1981

半導体製造用全自動レジスト塗布装置
「TR5000」シリーズを開発、製造・販売を開始

Developed the fully automated photoresist coater 'TR5000' series and launched production and sales through Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.

1989

液晶用カラーフィルター製造装置
「TR25000」シリーズを開発、製造・販売を開始

Developed the TR25000 series TFT full-color filter manufacturing equipment and launched production and sales.

1990

本社・本社工場を新築し、
岡山県井原市木之子町に移転

Relocated to a newly constructed head office and plant at Kinoko-cho, Ibara City, Okayama.

1993

8インチウェーハ対応半導体製造装置を
開発、製造・販売を開始

Developed semiconductor manufacturing equipment compatible with 8-inch wafers and launched production and sales.

2001

半導体製造用厚膜コーター
「CS13」シリーズを開発、製造・販売を開始

第5世代対応カラーフィルター製造装置を
開発、製造・販売を開始

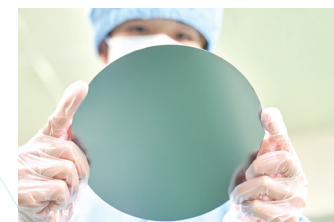
Developed the 'CS13' series thick-film coater for semiconductor manufacturing and launched production and sales.

Developed 5th-generation full-color filter manufacturing equipment and launched production and sales.

2004

JASDAQ市場に株式を上場
(現:東証スタンダード市場)

Listed on JASDAQ (now Tokyo Stock Exchange Standard Market)



2018

東京証券取引所第二部へ市場変更

東京証券取引所第一部へ市場変更

Moved from JASDAQ to the Second Section of the Tokyo Stock Exchange.

Moved from the Second Section to the First Section of the Tokyo Stock Exchange.

2019

本社を新築し、岡山県岡山市へ移転

Relocated to a newly constructed head office at Okayama City, Okayama.

2022

東京証券取引所市場第一部から
プライム市場に移行

TAZMO transitioned from the First Section to the Prime Market on the Tokyo Stock Exchange.

2023

2023年2月26日 創立50周年
50th Anniversary on February 26, 2023.



Products

最先端の技術で、見えないところから日常を支える

Supporting everyday life behind the scenes with cutting-edge technology



貼合剥離装置

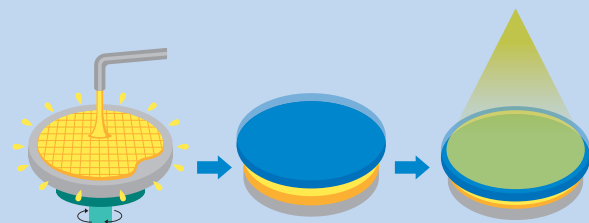
Bonder / Debonder

スマホやAI向けの高性能チップを作るには、ウェーハの薄化が不可欠です。貼合剥離装置はウェーハにガラス支持体を貼り合わせることで、ウェーハへの損傷がなく薄化を可能にする装置です。研削後は、ウェーハと支持体を傷つけずに剥離します。

Wafer thinning is essential for producing high-performance chips used in smartphones and AI. The bonding/debonding system enables thinning without damaging the wafer by attaching it to a glass carrier. After grinding, the wafer and carrier are separated without harm.



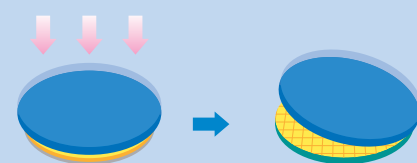
貼合 Bonder



デバイスウェーハに接着剤をスピン塗布し、剥離層が塗布されたガラス支持体と合わせます。その後、光を照射することでデバイスウェーハに塗布した接着剤が硬化し、貼合が完了します。

An adhesive is spin-coated onto the device wafer and bonded to a glass carrier with a release layer. Lights is then applied to cure the adhesive on the wafer, completing the bonding process.

剥離 Debonder

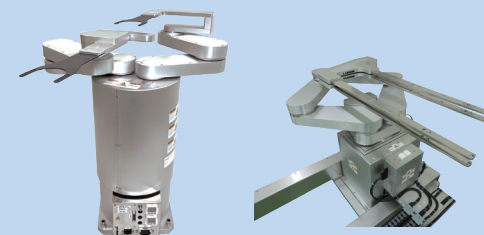


レーザー照射することで、ガラス支持体に塗布されていた剥離層が粉状に変化し、デバイスウェーハとガラス支持体を傷つけることなく剥離します。剥離されたデバイスウェーハやガラス支持体の残渣はこの後取り除かれます。

Laser irradiation turns the release layer on the glass carrier into a powder, enabling separation from the device wafer without damage. Residues on the separated wafer and glass carrier are then removed.

搬送機器

Clean Transfer System



搬送ロボット

Transfer robots

搬送ロボットは、装置内で半導体ウェーハやガラス基板を安全かつ正確に搬送するロボットです。人の手を使わずに自動で運ぶことで、汚染リスクを減らし生産性を向上させます。

Transfer robots safely and precisely move semiconductor wafers and glass substrates within the system. By automating transport without human contact, they reduce contamination risk and improve productivity.

プリアライナー

Pre-Aligner

プリアライナーは、ウェーハのオリフラ/ノッチ合わせやセンタリングを行い、次の工程で処理する位置へ正確に配置するための装置です。

The Pre-Aligner adjusts wafer orientation by aligning the notch or flat and centering the wafer, ensuring accurate positioning for the next process.

EFEM

EFEM

EFEMはユニット(搬送ロボット、アライナー、ロードポート、FFU等)をフレームに組み込んだ製品です。

EFEM is a system that integrates units such as transfer robots, aligners, load ports, and FFUs into a single frame.



塗布・現像装置

Coater/Developer

AI向け電子部品は膜を何層も重ねる構造であり、膜の均一性が製品の品質に影響します。塗布装置ではレジストを部品表面に均一に塗布し、現像装置で露光された部分のみを洗い流すことで精密な回路作りを可能にしています。

Electronic components for AI applications are made by layering multiple films, and the uniformity of these films significantly affects product quality. Coating equipment applies photoresist evenly to the surface, and developing equipment washes away only the exposed areas, enabling the creation of precise circuits.

洗浄装置

Cleaning System



洗浄装置は、ウェーハに付着した汚染物質を除去し、後工程での欠陥を防ぐ装置です。微細化が進むなか、品質維持のため各工程間で繰り返し使用され、良品率の向上に寄与しています。

Cleaning systems are used to remove contaminants adhered to wafers, preventing defects in subsequent processes. As device miniaturization advances, these systems are repeatedly utilized between each manufacturing step to maintain quality and contribute to improved yield.



スラリー供給装置

CMP Slurry Distribution Systems

半導体製造では、回路を正しく作るためにウェーハ表面を平らに磨く工程があります。スラリー供給装置は、ウェーハを均一に研磨するため、濃度など正確に管理したスラリーを安定供給することで精密な仕上がりに貢献する装置です。

In semiconductor manufacturing, the wafer surface must be polished flat to form circuits correctly. CMP Slurry Distribution Systems contribute to precise surface finishing by stably supplying slurry with accurately controlled concentration and properties, enabling uniform wafer polishing.



リン酸再生装置

Phosphoric Acid Reclamation Process Equipment

リン酸再生装置は、洗浄工程で利用したリン酸を回収し、再利用を可能にする装置です。廃液削減、つまりは環境問題に配慮しながらコストダウンも実現する特別な装置です。

Phosphoric Acid Reclamation Process Equipment is used to recover and recycle phosphoric acid utilized in cleaning processes. This specialized system helps reduce wastewater, addressing environmental concerns while also contributing to cost reduction.





Team

技術を武器に、新たな市場へ

Harnessing Technology to Enter New Markets

変化し続ける半導体市場。その最前線で、タツモは技術力を武器に新たな市場を切り拓いてきました。培ってきた開発力と革新の精神で、これからも世界のニーズに応え、未来のものをづくりを支えていきます。

The semiconductor market continues to evolve. At the forefront of this dynamic field, TAZMO has carved out new markets with its technological strength as a key driving force. Backed by our proven development capabilities and spirit of innovation, we will continue to meet global needs and support the future of manufacturing.

マーケティング

Marketing

お客様の生の声が開発の原点

価値ある製品づくりの出発点は、お客様の声を聞くことです。外へ出て求められるものを徹底的にリサーチすることが、タツモにしかできない独自の発想と技術への挑戦につながると考えています。

Customer Voices: The Foundation of Our Development

Listening to our customers is where creating value-driven products begins. We believe that stepping out into the field and thoroughly researching customer needs leads to challenges that drive TAZMO's unique ideas and technology.



開発

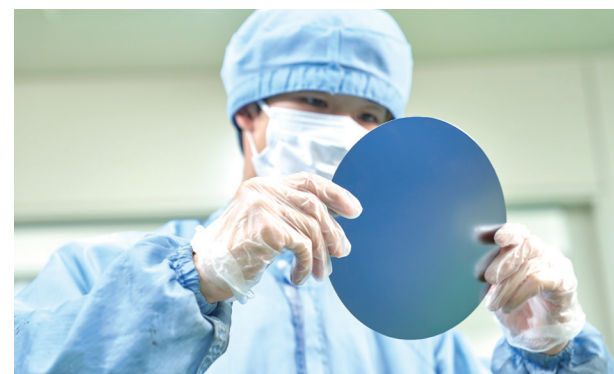
Development

常識の先にあるタツモのものづくりの核

タツモのものづくりは、常識の先を見ることから始まります。当たり前を問い直し、発想を磨く——。そこから唯一無二の製品が生まれるのです。創造は、常識を超えたその先にある。私たちはそう信じています。

Beyond Common Sense: The Heart of Our Innovation

Innovation begins where common sense ends. By rethinking assumptions and sharpening our ideas, we create truly original products. We believe that creativity is found not within convention—but beyond it.



設計

Design

確かな設計で最適な仕様を実現

タツモの設計は、ニーズを的確に捉え、製品仕様へと反映する役割を担っています。豊富な知見と技術を活かし、多様な要望に柔軟に対応。機能性と効率性を備えた設計で、コストにも配慮し、ものづくりを支えています。

Reliable Design for Optimal Specifications

Translating diverse customer needs into concrete specifications is a key role of our design team. With deep expertise and flexibility, we create cost-conscious designs that combine function and efficiency.

製造

Manufacturing

高品質を支える、生産性と効率性の追求

多様化・高度化するニーズに応えるため、タツモでは生産性と効率性の向上に継続的に取り組んでいます。協力会社との連携も活かしながら、柔軟な対応を可能にする生産体制を整備。こうした取り組みの積み重ねが、高品質な製品づくりへとつながっています。

Pursuing Productivity and Efficiency for High Quality

TAZMO continuously works to improve productivity and efficiency to meet diverse customer needs. By partnering with suppliers and enhancing flexibility, we build a system that supports high-quality manufacturing.

Office & Plant

技術で広がるタツモのネットワーク

TAZMO's Expanding Network Through Technology



タツモ株式会社

本社
岡山県岡山市
Head Office
Okayama City, Okayama

第1工場
岡山県井原市
Plant 1
Ibara City, Okayama

第3工場
岡山県井原市
Plant 3
Ibara City, Okayama

第5工場
岡山県井原市
Plant 5
Ibara City, Okayama

東京営業所
東京都新宿区
Tokyo Office
Shinjuku-ku, Tokyo

四日市サポートセンター
三重県四日市市
Yokkaichi Support Center
Yokkaichi City, Mie

北上サポートセンター
岩手県北上市
Kitakami Support Center
Kitakami City, Iwate

国内グループ会社

プレテック株式会社
岡山県井原市
PRETEC Co.,Ltd.
Ibara City, Okayama

株式会社クォークテクノロジー
岡山県井原市
Quark Technology Co.,Ltd.
Ibara City, Okayama

株式会社ファシリティ
神奈川県相模原市
Facility Co.,Ltd.
Sagamihara City, Kanagawa

ファシリティ出雲研究所
島根県出雲市
Facility Izumo Laboratory
Izumo City, Shimane

海外グループ会社

TAZMO INC.
米国 カリフォルニア州フリーモント
TAZMO INC.
Fremont, California, USA

富萊得(香港)有限公司
香港沙田区安平街
Facility Hong Kong Ltd.
An Ping Street, Sha Tin District, Hong Kong

富萊得科技(東莞)有限公司
中国広東省 東莞市
Facility Technology (Dongguan) Co.,Ltd.
Dongguan City, Guangdong Province, China

上海龍雲精密機械有限公司
中国上海市松江区
Shanghai TAZMO Precision
Machinery Co.,Ltd.
Songjiang District, Shanghai, China

龍雲(紹興)半導体設備科技有限公司
中国浙江省紹興市
TAZMO Semitec Shaoxing
Technology Co.,Ltd.
Shaoxing City, Zhejiang Province, China

龍雲研創(紹興)電子科技有限公司
中国浙江省紹興市
TAZMO INNOVATION SHAOXING
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
Shaoxing City, Zhejiang Province, China

龍雲同舟(紹興)電子科技有限公司
中国浙江省紹興市
TAZMO TONGZHOU SHAOXING
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.
Shaoxing City, Zhejiang Province, China

龍雲亞普恩科技股份有限公司
台湾 新竹県 竹北市
TAZMO Apprecia Formosa Inc.
Zhubei City, Hsinchu County, Taiwan

FACILITY HANOI CO.,LTD.
ベトナム フンイエン省 ヴァンラム県
FACILITY HANOI CO.,LTD.
an Lam District, Hung Yen Province,
Vietnam

TAZMO VIETNAM CO.,LTD.
ベトナム ロンアン省 カンジュオック県
TAZMO VIETNAM CO.,LTD.
Can Giuoc District, Long An Province,
Vietnam

PATA FACILITY Co.,Ltd.
タイ サムットサーコーン県
PATA FACILITY Co.,Ltd.
Samut Sakhon Province, Thailand

タツモ株式会社

〒701-1221 岡山県岡山市北区芳賀5311
TEL. 086-239-5000 FAX. 086-239-5100

TAZMO CO.,LTD.

5311, Haga, Kita-ku, Okayama-shi, Okayama, 701-1221, JAPAN
TEL. +81(86)239-5000 FAX. +81(86)239-5100

